RF マグネトロンスパッタ法を用いた GaN 薄膜の 作製と評価に関する研究

Study on Fabrication and Evaluation of GaN thin films by RF Magnetron Sputtering

○仲嶋 徹, 黒田 寛, 佐藤 祐喜, 大鉢 忠, 吉門 進三 (同志社大院理工), 竹本 菊郎, 宇野 裕行, 木村 直人, 高崎 正規 (ヤマナカヒューテック(株))

• Toru Nakajima, Hiroshi Kuroda, Yuuki Sato, Tadashi Ohachi, Shinzo Yoshikado (Doshisha Univ.), Kikuro Takemoto, Hiroyuki Uno, Naoto Kimura, Masanori Takasaki (Yamanaka Hutech Corporation) E-mail: syoshika@mail.doshisha.ac.jp

【はじめに】環境およびエネルギー問題が地球規模で議論されている昨今,民生及び産業機器の 各種電力変換部分において,幅広く用いられるパワーデバイスの省エネルギー化が強く求められ るに至っている。しかしながらデバイスに用いられる Si は性能限界に近付いており,近年は直接 遷移型半導体であり,ワイドバンドギャップ半導体である窒化ガリウム (GaN) に注目が集まって いる。また,GaN は適切なドーピング元素を加えることで,バンドギャップを制御することが可 能なので,太陽電池への応用も期待されている。そこで我々は,最終的な目標を,多結晶 GaN の 単接合薄膜太陽電池の作製として,まずは高特性な GaN 薄膜の作製を目指した。一般的に GaN 薄膜は 800℃ 以上の高温で MOCVD 法や MBE 法で作製されている。一方で安全性や製膜速度が 遅いという課題がある。そこで我々は,粉末ターゲットが使用可能で,製膜速度が比較的速く, 大面積に製膜可能な薄膜作製方法である RF マグネトロンスパッタを用いた。特にスパッタター ゲットに高純度な GaN 粉末を用い,製膜条件を種々変化させて製膜し評価した。

【実験方法】Ga₂O₃含有量が極めて少ない高純度な GaN 粉末(純度 99.999%以上)を用いた。単結 晶サファイア基板(c面)上に, N₂ガスを用いて,製膜時の圧力:0.6Paとして,放電周波数 13.56 MHz,印加電力:200W,基板温度:室温~700℃,製膜時間:2,6時間として製膜した。また GaN 粉末に Si を 1mol%添加した製膜も行った。なお,いずれの薄膜も基板加熱前の圧力を 2×10⁻⁴ Pa 以下とした。試料の膜厚測定,AFM による表面観察,X線結晶構造解析 (2*θ-ω*,極点図), 抵抗率の温度依存性の測定を行った。

【実験結果・考察】結晶構造は基本的には六方晶であった。基板温度が 700°C のとき急激に(002) 面が成長することが分かった。また理想的な GaN の格子定数よりも大きくなっていることが分か

った。これは GaN とサファイア基板の格子不整は 16%あり,製膜した GaN 薄膜はサファイア基板の 引張り応力の影響を受けたためであると考えられ る。極点図より,基板温度が 200℃ のとき, {010}, {002}, {011}面に配向した結晶が支配的であり,基 板温度を 700℃ のとき, {002}面と {011}面に配向し た結晶が支配的であることが分かった。またいずれ の製膜条件の薄膜でも, {002}面の半値幅は 1°程度 であり, c 面以外の面では半値幅がブロードで測定 出来ず,面方向の揺らぎが大きいことが分かった。

Fig.1にSiノンドープで基板温度を200°Cで製膜時間を6時間とした薄膜と基板温度を700°Cで製膜時間を2時間および6時間とした薄膜および,Siを1mol%ドープして基板温度を200°Cおよび700°Cで製膜時間を6時間とした薄膜の抵抗率の温度特性を示す。Siを添加しないとき,基板温度が700°Cでは200°Cと比較して抵抗率が大幅に減少した。またプロットの傾きが変化した。また,Siの添加の有無に依らず抵抗率は大きな変化しなかった。これより,製膜チャンバー内に残存している酸素がGaN薄膜に取り込まれやすくなり,酸素がドープされている状態になったことを示唆する結果が得られた。



Fig.1 Substrate temperature dependence of the resistivity of GaN thin films.